(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開番号

特開平5-288510

(43)公開日 平成5年(1993)11月2日

(51)Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G01B 11/00

A 7625-2F

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平4-85252

(22)出願日

平成 4年(1992) 4月7日

(71)出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号

(72)発明者 桂 浩輔

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 恒次 秀起

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

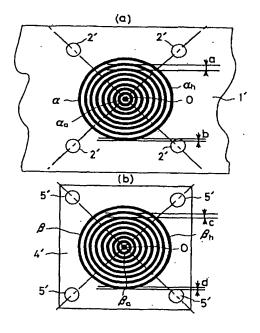
(74)代理人 弁理士 菅 隆彦

(54)【発明の名称】 チップ位置ズレ測定方法

(57)【要約】 (修正有)

[目的] チップがどの方向にずれても、容易に正確にチ ップの位置ズレを測定することが出来、その上、捻れ回 転したチップの位置ズレに対しても同一の精度で測定可 能とする。

【構成】基板1′の表面上に、バンプ用電極パタン2′ とパンプ用電極パタン2′と主尺目盛り位置ズレ検出パ タンαをパタン形成すると共化、他方のチップ4′の対 向表面上に、パンプ用電極パタン5′と、副尺目盛り位 置ズレ検出パタンβをパタン形成し、バンブ用電極上 2′,5′に形成したバンプを介してフリップチップ接 続した後、チップ4′若しくは基板1′を光学的に透過 して、チップ4′と基板1′対向面にそれぞれパタン形 成した主尺目盛り位置ズレ検出パタンαと、副尺目盛り 位置ズレ検出パタンβの重合状態から、基板1′に対す るチップ4′の位置ズレを測定することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

(請求項1) I Cチップ若しくはそれに類する形状のチ ップが、バンプ用電極バタンを介して基板と相対時位置 決め接続するフリップチップ接続法に於ける位置決め接 続後のチップ位置ズレ測定方法に於いて、前記フリップ チップ接続を行うチップ或いはこれに対向する基板の何 れか一方の表面上に、バンブ用電極バタンと当該バンブ 用電極パタンと任意所定位置関係の中心点より十重二重 に複数の同心相似形線を放射方向等ピッチ間隔で配置す る主尺目盛り位置ズレ検出パタンをパタン形成すると共 10 に、他方のチップ或いは基板の何れかの表面上に、前記 バンブ用電極バタンと同一寸法でかつ同一位置に配置す るパンプ用電極パタンと、当該パンプ用電極パタンと前 記同様任意所定位置関係の中心点より十重二重に複数の 同心相似形線をとれと同一形状の前記対向する同心相似 形線に比して所定の値だけ僅かにずらした間隔で等ピッ チ間隔で配置する副尺目盛り位置ズレ検出バタンをバタ ン形成し、前記パンプ用電極上に形成したパンプを介し てフリップチップ接続した後、前記チップ若しくは基板 を光学的に透過して、前記チップと基板対向面にそれぞ 20 れパタン形成した前記主尺目盛り位置ズレ検出パタン と、副尺目盛り位置ズレ検出バタンの重合状態から、前 記基板に対するチップの位置ズレを測定することを特徴 とするチップ位置ズレ測定方法

【請求項2】主尺目盛り位置ズレ検出バタンと、副尺目 盛り位置ズレ検出パタンのそれぞれ同心相似形線は、無 端連続又は不連続パタンであることを特徴とする請求項 1 記載のチップ位置ズレ測定方法

【請求項3】主尺目盛り位置ズレ検出パタンと、副尺目 盛り位置ズレ検出パタンの同心相似形線は、同心円パタ ンとドッパタンと一部が直線パタンと、これ等の複数組 合せパタンのいずれかであることを特徴とする請求項1 又は2記載のチップ位置ズレ測定方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置等に用いら れるICチップ等のフリップチップ接続に於ける高精度 なチップ位置ズレ測定方法に関する。

[0002]

【従来の技術】フリップチップ接続法は、【Cチップと 40 基板若しくはICチップ同士の相対峙位置決め接続に於 いて、高密度な電極接続若しくは微小な寸法の電極接続 に有効な実装方法である。

【0003】近年、とのフリップチップ接続法は、接続 時の位置決め精度の向上により、昭和62年電子情報通 信学会半導体·材料部門全国大会講演論文集(分冊 2), 338頁, S9-6に代表される様に、受光素子 や面発光レーザ等の光デバイスチップとレンズや光導波 路等の光部品を構成した基板との位置決め対向接続に用

接続法に於いては、フリップチップ接続後の両者の位置 ズレが問題となる。

【0004】とのためフリップチップ接続時の位置ズレ を正確に検査する必要が生じる。との種、従来のフリッ プチップ接続による位置ズレ測定方法としては、図4に 示す様なマーカによる測定が一般的であった。図中、1 は透明なガラス材からなる疑似基板、2,5はバンプ用 電極パタン、3はパンプ、4はチップ、6 a、6 bはマ **ーカである。**

【0005】当該従来の位置ズレ測定方法は、疑似基板 1と当該疑似基板1上にフリップチップ接続するチップ 4の対向面に、それぞれバンプ用電極バタン2.5を形 成すると同時に、当該電極パタン2,5と任意一定の位 置関係を有し、位置ズレがない状態で上方から観察する と、完全に重合する様に前記疑似基板 1 側にマーカ 6 a を、亦、前記チップ4側にマーカ6bをそれぞれ形成 し、バンプ3を用いてフリップチップ接続した後に、前 記マーカ6a, 6bのズレしを透明な前記疑似基板1側 より、図示しない顕微鏡により拡大し、測長器等で読み とる方法が一般的であった。この方法は、位置ズレしの 読み取りが、マーカ6a,6bの幅より大きな精度でよ い場合には、有効な位置ズレ測定方法である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、当該従 来の位置ズレ測定方法に於いては、位置ズレしが微小な 場合、特にマーカ6a, 6b自身の読み取り誤差や、測 定に用いる測長器の精度等により測定誤差が大きくなる 可能性があった。

【0007】即ち、マーカ6a, 6bの幅以下の精度の 測長では、そのズレレを当該マーカ6 a. 6 bのエッジ 部分や中央をを正確に判別して測長せざるを得ず、読み 取り誤差が大きくなる問題があった。亦、顕微鏡等を用 いて光学的に対象物を透過・拡大し、画像情報として測 長を行う測長器を用いた場合には、顕微鏡の収差等によ り、透過・拡大した像が歪み、正確な測長が困難であっ た。

【0008】一方、微動台により対象物を移動させ、マ ーカを読み取る測長器では、微動台のバックラッシュ等 により正確な測長が得難くなる可能性があった。亦、フ リップチップ接続の際、位置決め接続する対象物同士が 捻れて接続された場合には、マーカ自身の配置も捻れて 測定誤差が大きくなる問題があった。ここに於いて、本 発明は前記従来の課題に鑑み、フリップチップ接続に於 けるICチップの微小な位置ズレを、正確に測定出来る チップ位置ズレ測定方法を提供せんとするものである。 [0009]

【課題を解決するための手段】前記課題の解決は、本発 明が次に列挙する新規な特徴的構成手法を採用すること により達成される。即ち、本発明の第1の特徴は、IC いられるようになってきているが、当該フリップチップ 50 チップ若しくはそれに類する形状のチップが、バンブ用

電極パタンを介して基板と相対時位置決め接続するフリ ップチップ接続法に於ける位置決め接続後のチップ位置 ズレ測定方法に於いて、前記フリップチップ接続を行う チップ或いはこれに対向する基板の何れか一方の表面上 に、バンプ用電極パタンと当該バンプ用電極パタンと任 意所定位置関係の中心点より十重二重に複数の同心相似 形線を放射方向等ビッチ間隔で配置する主尺目盛り位置 ズレ検出バタンをバタン形成すると共化、他方のチップ 或いは基板の何れかの表面上に、前記パンプ用電極パタ ンと同一寸法でかつ同一位置に配置するバンブ用電極バ 10 タンと、当該バンプ用電極パタンと前記同様任意所定位 置関係の中心点より十重二重に複数の同心相似形線をと れと同一形状の前記対向する前記同心相似形線に比して 所定の値だけ僅かにずらした間隔で等ピッチ間隔で配置 する副尺目盛り位置ズレ検出パタンをパタン形成し、前 記パンプ用電極上に形成したパンプを介してフリップチ ップ接続した後、前記チップ若しくは基板を光学的に透 過して、前記チップと基板表面にそれぞれパタン形成し た前記主尺目盛り位置ズレ検出パタンと、副尺目盛り位 置ズレ検出バタンの重合状態から、前記基板に対するチ ップの位置ズレを測定してなるチップ位置ズレ測定方法 である。

【0010】本発明の第2の特徴は、前記第1の特徴に 於ける主尺目盛り位置ズレ検出バタンと、副尺目盛り位 置ズレ検出バタンのそれぞれ同心相似形線は、無端連続 又は不連続バタンであるチップ位置ズレ測定方法であ る。

【0011】本発明の第3の特徴は、前記第1又は第2の特徴に於ける主尺目盛り位置ズレ検出バタンと、副尺目盛り位置ズレ検出バタンの同心相似形線は、同心円バ 30タンとドットバタンと一部が直線バタンと、これ等の複数組合せバタンのいずれかであるチップ位置ズレ測定方法である。

[0012]

【作用】本発明は、前記の様な手段を講じたので、ノギスに使用される主尺目盛りと副尺目盛りとを同心相似形線パタンとし、半導体製造技術によりパンプ電極から所定の間隔を隔てて形成し、微小位置ズレを前記主尺目盛りパタンと副尺目盛りパタンとの重合情報として読み取るので、パタンのエッジや中央等を正確に読み取る必要がなく、亦、顕微鏡等の収差や機械的なズレが測長に影響するととがなくなる。

【0013】よって、チップがどの方向にずれたとしても、精密な測長装置を用いずに、容易に正確なチップの位置ズレ測定が実現出来る。更に、前記主尺目盛りパタンと副尺目盛りパタンが相互に対応相似形線であるため、捻れ回転した対象物の位置ズレも容易に測定可能となる。

[0014]

(実施例)

(第1実施例) 本発明の第1実施例を図面につき詳説する。図1は本実施例のチップ位置ズレ測定方法に用いる位置ズレ検出パタンの平面図であって、(a)は接続基板上に、亦、(b)はチップ上に形成されるものである。図中、1′は例えばセラミック配線板である接続基板、2′、5′はそれぞれ下側と上側のパンプ用電極パタン、4′はチップ、αは接続基板1′上に形成された位置ズレ検出パタン、βはチップ4′上に形成された位置ズレ検出パタンである。

【0015】図1(a)に示す様、接続基板1′上に、20μmφのパンプ用電極パタン2′を四隅に一個ずつ形成し、当該下側パンプ用電極パタン2′同志を結ぶ斜線の交点を中心点0として、当該中心点0からの円周ピッチaを例えば10μmと等間隔になる様配置すると共に、例えばパタン幅bを5μmに統一設定した複数の同心円αa~αhの円周が主尺目盛り位置ズレ検出パタンαをフォトリソグラフィ技術等の半導体形成技術により同時に形成する。

【0016】他方、ダイシングすると多くのチップに裁 的することの出来る半導体ウェハのチップ4 の対向面 に、前記接続基板1 ′ 上に形成する下側パンプ用電極パタン2 ′ と同一配置及び同一寸法の下側パンプ用電極パタン5 ′ を形成すると共に、各チップ4 ′ 毎に前記接続 基板1 ′ 同様、当該上側パンプ用電極パタン5 ′ の対角線の交点を中心点0として、当該中心点0からの円周ピッチでを例えば9.9μmと等間隔になる様配置すると共に、例えばパタン幅 dを5μmに統一設定した複数の 同心円βα~βhの円周が副尺目盛り位置ズレ検出パタンβをフォトリソグラフィ技術等の半導体形成技術によ 30 り同時に形成する。

【0017】その後、ウェハ上の各チップ対応の上側バンプ用電極パタン5′に、例えばAuSnやSnPbのパンプを形成し、前記ウェハを裁断して単独のチップ4′とし、両面位置合わせ装置等によりフェイスダウンで前記接続基板1′と当該チップ4′対向面上に形成したパンプ用電極パタン2′及び5′同士を精密に相対峙位置合わせし、前記チップ4′を前記接続基板1′上にボンディングしてフリップチップ接続を行う。

【0018】次に、当該フリップチップ接続を終了した 40 試料を、前記接続基板1′及びチップ4′対向表面に形成した2つの同心円状の位置ズレ検出パタンα、βの重合を、赤外線顕微鏡により前記チップ4′を透過して拡大観察し、主尺目盛り位置ズレ検出パタンαと、副尺目盛り位置ズレ検出パタンβの重合位置を読み取り、その目盛りからゼロ中心、即ち位置ズレがゼロの時に前記主尺目盛りと副尺目盛りとが完全に重合する目盛りである同心円の中心点0までの目盛りの本数からチップ4′の接続基板1′に対する位置ズレを測定する。

【0019】本実施例のチップ位置ズレ測定方法によれ 50 ば、円周ビッチαが10μmの同心円αα~αhの主尺 目盛り位置ズレ検出パタンαと、円周ピッチcが9.9 μmの同心円βα~βhの副尺目盛り位置ズレ検出パタ ンβにより、チップ4′ がどの方向にずれても0. 1 μ mと高い精度で位置ズレの検出が可能となり、位置ズレ が目盛りバタン幅b、dの5μmよりも小さなズレであ っても、精密な測長装置を用いることなく、顕微鏡でチ ップ4′を透過して前記位置ズレ検出パタンα、βの重 合を観察するだけで、容易にチップ位置ズレを測定出来 る。亦、主尺・副尺目盛りを円状に形成しているので、 接続されたチップ4′と接続基板1′が相互に捻れた位 10 置関係であっても、支障なく同一の精度で測定可能であ

【0020】尚、本実施例では、主尺目盛り位置ズレ検 出バタン α の同心円 α a \sim α h円周バタンピッチaを1 Oμm, 副尺目盛り位置ズレ検出バタンβの同心円βa ~βh円周パタンピッチcを9.9μmとしたが、本発 明のチップ位置ズレ測定方法により必要な測定精度Xを 得るためには、当該必要な測定精度Xより前配主尺目盛 り位置ズレ検出パタンαの同心円αα~αト円周パタン ピッチaをひいたピッチ (X-a) となる様、前記副尺 20 目盛り位置ズレ検出バタンBの同心円Ba~Bh円周パ タンピッチcを定め、ゼロ中心の目盛りから当該ピッチ a及びc(=X-a)で等間隔に円状の目盛りを配置形 成すれば良い。亦、本実施例に於いては接続基板1′表 面に主尺目盛りを配置し、チップ4′表面に副尺目盛り を配置したが、チップ4′側に主尺目盛りを、且つ接続 基板 1′側に副尺目盛りを配置しても同様の効果を得ら れることは言うまでもない。

【0021】(第2実施例)本発明の第2実施例を図面 につき詳説する。図2 (a), (b), (c), (d) は、本実施例に用いる位置ズレ検出バタンのバリエーシ ョンを示す平面図である。第1実施例に於いては、主尺 ・副尺目盛りが同心円状のパタンである場合に付き説明 したが、本実施例の如く主尺・副尺目盛りパタンの一方 又はその両方が、同心円を裁断した不連続バタンであっ てもかまわない。

【0022】ととで図2の位置ズレ検出パタンのパリエ ーションを各々に付き説明する。図2(a)は、同心円 α、βの円周をそのままある間隔で裁断した位置ズレ検 出バタンγである。図2(b)は、図1に示した同心円 40 々同時に測定出来る。本実施例では、直交十字線θaと α、βの円周の位置に、丸型のドットバタンを配置した 位置ズレ検出パタンるである。

【0023】図2(c)は、図1に示した同心円a、β の円周の位置に、角型ドットパタンを配置した位置ズレ 検出パタン ϵ である。図2(d)は、図1に示した同心 円α、βの円周の位置に、三角型ドットバタンを配置し た位置ズレ検出パタンωである。

[0024] 図2(a), (b), (c), (d) 化示 す位置ズレ検出パタン γ , δ , ϵ , ω によれば、図1の

が向上し、より正確な位置ズレ検出が可能となる。以上 のパタンは代表例であって、図2(b)、(c),

(d)のドットパタンにはどの様な形状のものを用いて も良いし、種類の異なるドットパタンを組み合わせても よい。

【0025】更に、図1で示した同心円状パタン、図2 (a)の裁断同心円状パタン及び図2(b), (c),

(d)の各種ドットパタンをそれぞれ複合して用いても 良いことは自明である。以上、前記第1及び第2本実施 例では、目盛りのゼロ中心(即ち位置ズレがゼロの時に 主尺と副尺とが完全に重合する目盛り)が同心円の中心 となる例のみ述べたが、本発明のチップ位置ズレ測定方 法はどの同心円の円周をゼロ中心としても良い。

【0026】亦、第1実施例に於いて、パタンの線幅 b, dを5 μm, バンプ用電極パタン2′, 5′寸法を 50μmφ四個, 配線基板1′材料をセラミック, バン プ材質をAuSn若しくはSnPbとしたが、本発明はこの値や 材質に制限されるものではなく、更に位置ズレ検出バタ ンα,βを四個の下側と上側のパンプ用電極パタン 2′,5′の対角線の交点に設定したが、当該バンプ用 電極パタン2′、5′に対して所定の間隔にあればどの 位置に配置形成しても良い。亦、前記第1実施例では、 位置ズレ検出パタンα、βとパンプ用電極パタン2′。 5′を同時に形成すると説明したが、所望の位置に正確

に位置ズレ検出パタンα、βを形成出来れば、同時に形

成する必要はない。

【0027】(第3実施例)本発明の第3実施例を図面 につき詳説する。図3(a). (b)はそれぞれ本実施 例のチップ位置ズレ測定方法に用いる主尺・副尺目盛り 30 位置ズレ検出バタンであって、(a)は図1に示す第1 実施例の同心円パタンと、その中心を通る5μmの直交 十字線を配した位置ズレ検出パタン、(b)は図1に示 す第1実施例の同心円パタンと、その外周に等間隔のド ットパタンを同心円状に配置した位置ズレ検出パタンで ある。図中、 θ 、 λ は位置ズレ検出パタンである。

【0028】本実施例の位置ズレ検出パタン θ , λ は、 基板1′とチップ4′対向表面に形成した後、前記第1 実施例同様にフリップチップ接続し、赤外線顕微鏡で観 察することにより、位置ズレだけでなく、捻れ角度も各 ドットパタンλαをそれぞれ別々のパタンとしたが、複 合したパタンを同心円パタンと共に形成しても良い。

【0029】亦、本実施例の直交十字線 θ a 付き同心円 パタンとドットパタンλ a 付き同心円パタンは、一方を チップに、他方を基板にと分けて形成しても良い。尚、 これ等実施例では、赤外線顕微鏡により試料を透過・拡 大して測長する例に付いて述べたが、基板若しくはチッ プを透過・拡大出来るものであればどの様な顕微鏡でも よく、例えばX線顕微鏡等であってもよいし、さらに基 位置ズレ検出パタンα. βと比してパタン重合の視認性 50 板若しくはチップを透明な材料で形成して、透明な方か ら通常の顕微鏡等で測長しても良い。

【0030】さらに、とれ等実施例では同心円バタンを基板とチップに描いたが同心円に限らず同一形状の同心相似形線バタンを用いても同様である。亦、とれ等実施例では基板とチップとのフリップチップ接続した試料に付いて述べたが、同一形状の相似形線バタンを有すれば、チップとチップ同士のフリップチップ接続した試料についしても位置ズレ測定にしよう出来るととは言うまでもない。

[0031]

【発明の効果】かくして本発明によれば、ノギスに使用される主尺目盛りと副尺目盛りとを同一形状の同心相似形線パタンとし、半導体製造技術によりパンプ用電極パタンから任意所定の間隔を隔てて形成し、位置ズレを主尺と副尺の重合パタンとして読み取ることを可能としたため、マーカの細かい読み取り誤差や測長器の精度に影響されることなく、チップがどの方向にずれても、容易にしかも正確にチップの位置ズレを測定することが出来、更に主尺と副尺目盛りを特に同心円状とすると、捻れ回転した対象物の位置ズレに対しても同一の精度で測定可能な効果を有する等、優れた実用性、有用性を具有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例のチップ位置ズレ測定方法*

* に用いる位置ズレ検出パタンの平面図であって、(a) は接続基板上に、亦、(b) はチップ上に形成されるものである。

【図2】(a),(b),(c),(d)はそれぞれ本 発明の第2実施例チップ位置ズレ測定法に用いる位置ズレ検出バタンのバリエーションを示す平面図である。

【図3】(a), (b)はそれぞれ本発明の第3実施例のチップ位置ズレ測定方法に用いる主尺・副尺目盛り位置ズレ検出パタンである。

10 【図4】従来のフリップチップ接続の位置ズレ測定方法を示す説明側面図である。

【符号の説明】

1 … 疑似基板

1′…接続基板

2.5,21,51…パンプ用電極バタン

3…バンプ

4, 4′ …チップ

6a, 6b…マーカ

0…中心点

20 α…接続基板上に形成された位置ズレ検出パタン

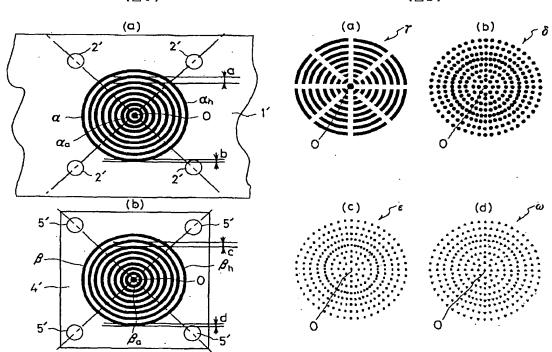
αa~αh, βa~βh…同心円

β…チップ上に形成された位置ズレ検出バタン

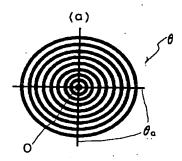
 γ , δ , ϵ , ω , θ , λ …位置ズレ検出バタン

【図1】

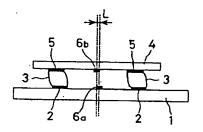
[図2]

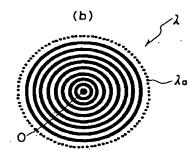


(図3)



【図4】





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第1区分 【発行日】平成11年(1999)9月17日

【公開番号】特開平5-28851C 【公開日】平成5年(1993)11月2日 【年通号数】公開特許公報5-2886 【出願番号】特願平4-85252 【国際特許分類第6版】

G01B 11/00

(FI)

G01B 11/00

【手続補正書】

【提出日】平成10年10月21日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項1】 I C チップ若しくはそれに類する形状のチ ップが、バンプ用電極パタンを介して基板と相対峙位置 決め接続するフリップチップ接続法に於ける位置決め接 続後のチップ位置ズレ測定方法に於いて、前記フリップ チップ接続を行うチップ或いはこれに対向する基板の何 れか一方の表面上に、バンブ用電極バタンと当該バンブ 用電極バタンと任意所定位置関係の中心点より十重二重 に複数の同心相似形線を放射方向等ピッチ間隔で配置す る主尺目盛り位置ズレ検出パタンをパタン形成すると共 に、他方のチップ或いは基板の何れかの表面上に、前記 バンプ用電極バタンと同一寸法でかつ同一位置に配置す るバンブ用電極パタンと、当該バンプ用電極パタンと前 記同様任意所定位置関係の中心点より十重二重に複数の 同心相似形線をとれと同一形状の前記対向する前記同心 相似形線に比して所定の値だけ僅かにずらした間隔で等 ピッチ間隔で配置する副尺目盛り位置ズレ検出パタンを パタン形成し、前記パンプ用電極上に形成したパンプを 介してフリップチップ接続した後、前記チップ若しくは 基板を光学的に透過して、前記チップと基板対向面にそ れぞれパタン形成した前記主尺目盛り位置ズレ検出パタ

ンと、副尺目盛り位置ズレ検出バタンの重合状態から、 前記基板に対するチップの位置ズレを測定することを特 徴とするチップ位置ズレ測定方法

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項3】主尺目盛り位置ズレ検出バタンと、副尺目盛り位置ズレ検出バタンの同心相似形線は、同心円バタンとドットバタンと一部が直線パタンと、これ等の複数組合せバタンのいずれかであることを特徴とする請求項1又は2記載のチップ位置ズレ測定方法

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正内容】

【0007】即ち、マーカ6a,6bの幅以下の精度の測長では、そのズレしを当該マーカ6a,6bのエッジ部分や中央を正確に判別して測長せざるを得ず、読み取り誤差が大きくなる問題があった。亦、顕微鏡等を用いて光学的に対象物を透過・拡大し、画像情報として測長を行う測長器を用いた場合には、顕微鏡の収差等により、透過・拡大した像が歪み、正確な測長が困難であった。